

锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定，将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736 股，每股发行价格为人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除各项发行费用合计人民币 3,943,396.22 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

| 项 目 | 金 额（元） |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 296,056,578.74 |
| 减：期初累计已使用募集资金的金额 | 123,485,320.46 |
| 减：本期已使用募集资金的金额 | 41,116,321.31 |
| 减：募集资金结余利息补充流动资金的金额 | 1,352.54 |
| 加：募集资金专项账户银行利息收入 | 4,024,374.67 |
| 募集资金专户余额 | 135,477,959.10 |
| 其中：募集资金专户余额 | 15,477,959.10 |
| 使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 | 120,000,000.00 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年9月，公司、国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|--------------------|---------------------|---------------|
| 招商银行锦州分行营业部 | 416900037710703 | 15,477,959.10 |
| 中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 | 0708004329200669624 | 已注销，零余额 |
| 合 计 | | 15,477,959.10 |

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

募集资金使用情况表详见本报告“附表：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 1-6 月，本公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1-6 月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年 1-6 月，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起止期限 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------|------|
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 收益凭证(结睿 24037 号) | 30,000,000.00 | 2024-11-20 至 2025-10-21 | 2.10% | 否 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 收益凭证(结睿 25112 号) | 10,000,000.00 | 2025-05-26 至 2025-07-28 | 1.75%-1.95% | 否 |
| 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 收益凭证(中金财富安享 919 号) | 10,000,000.00 | 2024-11-21 至 2025-07-28 | 2.19% | 否 |
| 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 收益凭证(中金财富安享 918 号) | 30,000,000.00 | 2024-11-21 至 2025-10-20 | 2.19% | 否 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025-06-16 至 2025-07-16 | 1.00%-1.85% | 否 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 收益凭证(结睿 24036 号) | 10,000,000.00 | 2024-11-20 至 2025-05-21 | 2.00% | 是 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 定期存款 | 15,000,000.00 | 2024-12-02 至 2025-06-02 | 1.50% | 是 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2024-12-06 至 2025-01-07 | 1.35%-2.05% | 是 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|---|
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 收益凭证(尧睿 25019 号) | 30,000,000.00 | 2025-01-27 至 2025-04-24 | 1.95%-2.15% | 是 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 定期存款 | 40,000,000.00 | 2025-04-28 至 2025-05-06 | 1.00% | 是 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 定期存款 | 1,880,000.00 | 2025-04-29 至 2025-05-07 | 1.00% | 是 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025-05-09 至 2025-06-09 | 1.3%-2.05% | 是 |

(六) 结余募集资金使用情况

2025 年 1-6 月，本公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月末，公司不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附表：

2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 29,605.66 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 4,111.63 | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 16,460.16 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目 | 否 | 21,000.00 | 20,905.66 | 20,905.66 | 4,111.63 | 7,712.05 | -13,193.61 | 36.89% | 2025 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | — | 8,748.11 | 48.11 | 100.55% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 30,000.00 | 29,605.66 | 29,605.66 | 4,111.63 | 16,460.16 | -13,145.50 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 详见“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 详见“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理，公司于 2024 年 12 月将募集资金结余利息收入 0.14 万元补充到公司银行存款账户。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |